

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

AD

00

REV

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

—

—

SEE SHEET 1

—

—

—

1

MATERIAL:
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
HOUSING: GLASS-FILLED POLYESTER.

2

GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING
(ENTIRE CONTACT): 1.27µm MIN NICKEL AND ACTION
PIN: 0.5µm MIN TIN\LEAD.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.

3

CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.

4

CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 1.

5

CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.

6

CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
UNCONTROLLED ENVIROMENT APPLICATIONS.

7

CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.
ADDITIONAL CHARACTERS OR MARKINGS, AS WELL AS THE LOCATION
OF THE MARKINGS, MAY BE ADDED FOR TRACEABILITY BASED UPON
MANUFACTURERS DISCRETION.

8

PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
PATTERN DEFINED BY CONTACT LAYOUT.

9

FOR ACTUAL PIN LOADING SEE "CONTACT LAYOUT".

10

FOR ACTUAL PIN DIMENSIONS SEE "CONTACT DIMENSIONS".

11

AREA RESERVED FOR KEYING PART (BASIC P/N 100525).

12

POLARIZATION FEATURE.

13

CONTACT CAVITIES SUITABLE FOR ø4.8 HIGH CURRENT, HIGH FREQUENCY OR
FIBRE OPTIC CONTACTS AS PER DIN 41626 (SEE ALSO NOTE 14 AND 15).

14

PATERN FOR FIBRE OPTIC CONTACTS.

15

NOT PLATED THROUGH HOLES, TO BE REPLACED BY ø5.9^{+0.1}_{0.0} PLATED THOUGH
HOLES IF STRAIGHT SOLDER CONTACTS ARE APPLIED.

16

NOT PLATED THROUGH HOLES.

17

TO BE MEASURED AT BOTTOM OF SHROUD.

18

CONNECTOR LUBRICATED WITH TELCORDIA APPROVED LUBRICANT,
TECHNICAL REFERENCE: TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEP 1992.

19

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

20

0.76µm MIN GOLD PLATING AT MATING SURFACES.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

B CARBO

24JAN05

CHK

G SKIPPER

24JAN05

APP'D

G SKIPPER

24JAN05

Tyco Electronics

Tyco Electronics Corporation
Harriaburg, Pa 17105-3608

NAME

MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM,
TYPE M

DIMENSIONS:

mm

0-PLG

±

—

1-PLG

±

0.2

2-PLG

±

0.02

3-PLG

±

0.005

4-PLG

±

—

ANGLES

±

0.30°

PRODUCT SPEC

108-19082

APPLICATION SPEC

114-19029

MATERIAL

SEE SHEET 1

FINISH

SEE SHEET 1

WEIGHT

—

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A1

00779

100749

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE

4:1

SHEET

2

OF

2

REV

H

AMP 4805 REV 31MAR2000

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9